附件：

# **2022年度广东省科学技术奖公示表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **高产右旋龙脑梅片树资源化与综合利用关键技术推广** |
| **主要完成单位** | 广东华清园生物科技有限公司 |
| 华南理工大学 |
| 广东工业大学 |
| 中新国际联合研究院 |
| **主要完成人****（职称、完成单位、工作单位）** | 1.苏健裕（职称：教授级高级工程师、工作单位：华南理工大学、完成单位：华南理工大学、主要贡献：项目负责人，负责整体项目研发与应用工作，通过开展右旋龙脑结晶工程学研究，设计出适合右旋龙脑结晶的高效、绿色工艺流程与设备，解决了高纯度天然右旋龙脑制备的关键技术问题，并通过环糊精包埋、微乳化及化学接枝合成等技术解决了天然右旋龙脑的水溶性问题，实现了天然右旋龙脑在食品、药品、化妆品等中的应用与推广。支撑材料：代表性论文1的共同通讯作者，代表性论文2、3的通讯作者，代表性论文2、4的第一作者，专利6-10的第一发明人，其他证明材料：苏健裕“广东省脱贫攻坚先进个人”、广东省科技进步奖二等奖、全国发明展览会金奖、广东省农业技术推广奖二等奖） |
| 2.凌凤清（职称：高级工程师、职务：法人/董事长，工作单位：广东华清园生物科技有限公司、完成单位：广东华清园生物科技有限公司、主要贡献：参与项目设计与产业化应用推广工作，重点开展天然右旋龙脑GMP生产车间的建设，龙脑基衍生产品开发推广等工作。支撑材料：其他证明材料，凌凤清“广东省劳动模范”，专利4的第一发明人，结题验收材料1的项目负责人、成果评价材料1的共同完成人。 |
| 3. 傅明辉（职称：教授、工作单位：广东工业大学、完成单位：广东工业大学、主要贡献：开展了野生型梅片树良种的调查和筛选，负责优化梅片树良种扦插、组培繁育技术工艺，制定梅片树培育技术规程，良种梅片树组织培养的设计及实施。支撑材料：代表性论文5的通讯作者，专利3的第一发明人，专利1、2的主要发明人, 结题验收材料3主要负责人） |
| 4.方立明（职称：副研究员、工作单位：华南理工大学、完成单位：华南理工大学、主要贡献：参与项目设计与研发工作，重点参与了高纯度天然右旋龙脑提取工艺优化，龙脑重结晶及天然右旋龙脑结构表征等工作。支撑材料：代表性论文3的署名作者，专利9的主要发明人） |
| 5. 李琳（职称：教授、工作单位：华南理工大学、完成单位：华南理工大学、主要贡献：参与项目设计与研发工作，重点参与天然右旋龙脑提取制备、促跨膜吸收作用机理研究等工作。支撑材料：代表性论文1、2、4的署名作者，专利7的主要发明人） |
| 6. 郭玲（职称：无、工作单位：广东华清园生物科技有限公司、完成单位：广东华清园生物科技有限公司、主要贡献：主要完成人，参与项目的资料统计和应用推广。支撑材料：结题验收材料1的共同完成人） |
| 7. 刘志（职称：药师、工作单位：广东华清园生物科技有限公司、完成单位：广东华清园生物科技有限公司、主要贡献：参与项目设计与产品推广工作，重点参与天然冰片的提取制备、新型抗菌剂的研发推广等工作。支撑材料：代表性专利4的主要发明人，结题验收材料1的共同完成人，成果评价材料1的共同完成人） |
| 8. 王文（职称：无、职务：无，工作单位：中新国际联合研究院、完成单位：中新国际联合研究院、主要贡献：参与项目设计与产品推广工作，重点参与右旋龙脑为基料的衍生产品的开发、功效测试。）支撑材料：代表性论文3的第一作者，代表性专利6、10的主要发明人。 |
| 9. 姚燕飞（职称：助理工程师、工作单位：广东华清园生物科技有限公司、完成单位：广东华清园生物科技有限公司、主要贡献：参与项目设计与产品推广工作，重点参与右旋龙脑为基料的衍生产品的开发、功效测试。支撑材料：结题验收材料1的共同完成人） |
| **代表性论文****专著目录** | 论文1：<名称：Natural borneol enhances bisdemethoxycurcumin-induced cell cycle arrest in the G2/M phase through up-regulation of intracellular ROS in HepG2 cells、期刊：Food & Function、年卷：2015年6卷740-748页、第一作者：陈建平、通讯作者：苏健裕，陈填烽>  |
| 论文2：<名称：Preparation of Natural Borneol/2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin Inclusion Complex and Its Effect on the Absorption of Tetramethylpyrazine Phosphate in Mouse、期刊：Chemical and Pharmaceutical Bulletin、年卷：2012年60卷736-742页、第一作者：苏健裕、通讯作者：苏健裕> |
| 论文3：<名称：Nanoparticle-stabilized encapsulation of borneol and citral: Physicochemical characteristics, storage stability, and enhanced antibacterial activities、期刊：Journal of Food Science、年卷：2021年86卷4554-4565页、第一作者：王文、通讯作者：苏健裕> |
| 论文4：<名称：梅片树叶挥发油提取及成分分析、期刊：食品科学、年卷：2010年31卷399-401页、第一作者：苏健裕、通讯作者：陈玲> |
| 论文5：<名称：梅片树的组培快繁、期刊：分子植物育种、年卷：2016年14卷2791-2797页、第一作者：马笑宇、通讯作者：傅明辉> |
| **知识产权名称** | 专利1：<名称：一种梅片树组织培养的培养基及培养方法>（专利授权号：ZL 2017 1 0657718.1、发明人：马笑宇; 傅明辉、权利人：广东工业大学） |
| 专利2：<名称：一种梅片树愈伤组织的诱导与增殖方法>（专利授权号：ZL 2016 1 0206779.1、发明人：靳春萍; 傅明辉、权利人：广东工业大学） |
| 专利3：<名称：一种从梅片树叶片中提取天然右旋龙脑的预处理方法>（专利授权号：ZL 2018 1 1268928.2、发明人：傅明辉; 马笑宇、权利人：广东工业大学） |
| 专利4：<名称：一种用于生产天然冰片的冷却装置>（专利授权号：ZL 2019 2 2389976.3、发明人：凌凤清; 刘志、权利人：广东华清园生物科技有限公司） |
| 专利5：<名称：一种小孔型育苗容器>（专利授权号：ZL 2016 2 0356589.3、发明人：何波祥; 凌凤清; 林什全; 汪迎利; 连辉明; 张谦; 蔡燕灵; 周丽华; 陈一群; 曾令海; 殷祚云; 林胜; 李发辉、权利人：广东省林业科学研究院; 广东华清园生物科技有限公司; 广东森霖造绿有限公司） |
| 专利6：<名称：一种苯甲醛二冰片基缩醛衍生物及其制备方法与用途>（专利授权号：ZL 2018 1 0757225.X、发明人：苏健裕; 喻阿坤; 王文、权利人：华南理工大学） |
| 专利7：<名称：一种柠檬醛二冰片基缩醛衍生物及其制备方法与用途>（专利授权号：ZL 2018 1 0473491.X、发明人：苏健裕; 喻阿坤; 覃业霞; 徐振波; 李冰; 张霞; 李琳; 王丽、权利人：华南理工大学） |
| 专利8：<名称：一种基于龙脑的高分子抗菌材料和制备方法及其应用>（专利授权号：ZL 2019 1 1272633.7、发明人：苏健裕; 杨柳; 洪良智、权利人：中新国际联合研究院; 广东华清园生物科技有限公司） |
| 专利9：<名称：一种基于龙脑的聚合物及其制备方法与应用>（专利授权号：ZL 2019 1 1412816.4、发明人：苏健裕; 杨柳; 方立明; 孟晓风、权利人：华南理工大学） |
| 专利10：<名称：一种中药组合物、凝胶及其制备方法和应用>（专利授权号：ZL 2018 1 0360563.X、发明人：苏健裕; 杨柳; 郑华德; 胡菡; 王文; 程建华、权利人：华南协同创新研究院） |

**2022** 年度广东省科学技术奖公示表

（自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、科技成果推广奖格式）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 高阶HDI印制电路板的开发及其配套技术的创新集成应用 |
| **主要完成单位** | 单位 1 : 梅州市志浩电子科技有限公司 |
| 单位 2 |
| … |
| **主要完成人（职称、完成单位、工作单位）** | 1.刘亚辉（职称:未取得,工作单位:梅州市志浩电子科技有限公司,完成单位:梅州市志浩电子科技有限公司,主要贡献: 成果1: 高多阶HDI印制电路板对位系统高质创成及高精度阻抗设计方法。研究开发出高多阶HDI印刷电路板的制作方法，作出显著技术贡献，获高多阶HDI印刷电路板的制作方法（ZL201310136056.5）等授权发明专利；基于ZL201310136056.5专利，获2021年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛百强；成果3：先进印制电路高精度阻焊开窗及丝网塞孔方法。研究开发出印刷电路板阻焊开窗方法，作出技术贡献，获印刷电路板阻焊开窗方法（ZL201310145790.8）等授权发明专利。） |
| 2.戴晖（职称:助理工程师, 工作单位:梅州市志浩电子科技有限公司,完成单位:梅州市志浩电子科技有限公司,主要贡献: 成果2:高精高效机加工及其配套技术创新集成应用。研究开发出印制电路板机械大孔制作方法，获印制电路板机械大孔制作方法授权发明专利。成果3：先进印制电路高精度阻焊开窗及丝网塞孔方法。研究开发出印刷电路板丝网塞孔方法，获印刷电路板丝网塞孔方法授权发明专利。成果4：具有自主知识产权的先进印制电路智能制造系列系统及模块。核心参与开发智能制造系列系统及模块，发表《4G线路板产品的流程管控要点浅谈》技术论文。） |
| 3.刘喜科（职称:助理工程师, 工作单位:梅州市志浩电子科技有限公司,完成单位:梅州市志浩电子科技有限公司,主要贡献: 成果1: 高多阶HDI印制电路板对位系统高质创成及高精度阻抗设计方法。研究开发出HDI电路板盲孔偏位防呆测试方法，作出技术贡献，获HDI电路板盲孔偏位防呆测试方法（ZL2015108281934）授权发明专利；发表《多层HDI板叠孔制造工艺研究》技术论文。成果2:高精高效机加工及其配套技术创新集成应用。研究开发出一种印刷电路板的对角隔孔跳跃钻孔方法，作出技术贡献，获一种印刷电路板的对角隔孔跳跃钻孔方法（ZL201410431265.7）等授权发明专利。） |
| 4.蔡志浩（职称:未取得, 工作单位:梅州市志浩电子科技有限公司,完成单位:梅州市志浩电子科技有限公司,主要贡献: 成果4：具有自主知识产权的先进印制电路智能制造系列系统及模块。主导开发智能制造系列系统及模块，研究开发出化学沉积温控系统及其温度调节方法，获化学沉积温控系统及其温度调节方法（ZL2012102504174）授权发明专利。） |
| 5.刘根（职称:工程师, 工作单位:梅州市志浩电子科技有限公司,完成单位:梅州市志浩电子科技有限公司,主要贡献: 成果2:高精高效机加工及其配套技术创新集成应用。研究线路板高精度背钻方法，作出技术贡献，获“一种线路板高精度背钻方法及线路板（ZL202110426560.3）授权发明专利。发表《陶瓷填充PTFE高频混压板通孔等离子体去钻污参数选择》技术论文。成果3：先进印制电路高精度阻焊开窗及丝网塞孔方法。开展多类型孔同步树脂塞孔对位能力提升研究，发表《多类型孔同步树脂塞孔对位能力提升研究》技术论文。） |
| 6.张学平（职称:未取得, 工作单位:梅州市志浩电子科技有限公司,完成单位:梅州市志浩电子科技有限公司,主要贡献: 成果2:高精高效机加工及其配套技术创新集成应用。在研究树芯槽加工、背钻孔性能检测技术，作出技术贡献，获一种树芯槽加工方法及印制电路板（ZL202010124288.9）、一种背钻孔性能检测方法（ZL202010123920.8）授权发明专利。 |
| **代表性论文专著目录** | 论文 1：<名称《多层HDI板叠孔制造工艺研究》、期刊《印制电路信息》、年卷：2013年11卷、第一作者：刘喜科、通讯作者：刘喜科> |
| 论文 2：<名称《印制电路板化学金漏镀浅析》、期刊《印制电路信息》、年卷：2014年1卷、第一作者：戴晖、通讯作者：戴晖> |
| 论文 3：<名称《4G线路板产品的流程管控要点浅谈》、期刊《印制电路信息》、年卷：2016年1卷、第一作者：戴晖、通讯作者：戴晖> |
| 论文 4：<名称《多类型孔同步树脂塞孔对位能力提升研究》、期刊《印制电路信息》、年卷：2021年4卷、第一作者：刘根、通讯作者：刘根> |
| 论文 5：<名称《陶瓷填充PTFE高频混压板通孔等离子体去钻污参数选择》、期刊《印制电路信息》、年卷：2021年5卷、第一作者：刘根、通讯作者：刘根> |
| **知识产权名称** | 专利 1：<高多阶HDI印刷电路板的制作方法>（专利授权号：ZL2013101360565；发明人：刘亚辉，戴晖，刘喜科；权利人：梅州市志浩电子科技有限公司） |
| 专利 2：<印刷电路板丝网塞孔方法>（专利授权号：ZL201310136025X；发明人：戴晖，刘喜科，林人道；权利人：梅州市志浩电子科技有限公司） |
| 专利 3：<印刷电路板机械大孔制作方法>（专利授权号：ZL2013101360442、发明人：戴晖，刘喜科，林人道；权利人：梅州市志浩电子科技有限公司） |
| 专利 4：< HDI电路板盲孔偏位防呆测试方法>（专利授权号：ZL2015108281934；发明人：刘喜科，戴晖，张学平；权利人：梅州市志浩电子科技有限公司） |
| 专利 5：<一种印刷电路板的对角隔孔跳跃钻孔方法>（专利授权号：ZL2014104312657；发明人：刘喜科，戴晖，刘亚辉；权利人：梅州市志浩电子科技有限公司） |
| 专利6：<印制电路板阻焊开窗方法>（专利授权号：ZL2013101457908；发明人：刘亚辉，刘喜科，林人道；权利人：梅州市志浩电子科技有限公司） |
| 专利7：<化学沉积温控系统及其温度调节方法>（专利授权号：ZL2012102504174；发明人：冉彦祥，赵喜华，蔡志浩；权利人：梅州市志浩电子科技有限公司、东莞市威力固电路板设备有限公司） |
| 专利8：<一种树芯槽加工方法及印制电路板>（专利授权号：ZL2020101242889；发明人：张学平，刘喜科，戴晖；权利人：梅州市志浩电子科技有限公司） |
| 专利9：<一种背钻孔性能检测方法>（专利授权号：ZL2020101239208；发明人：张学平、刘喜科、戴晖；权利人：梅州市志浩电子科技有限公司） |
| 专利10：<一种线路板高精度背钻方法及线路板>（专利授权号：ZL2021104265603；发明人：刘喜科、刘根、戴晖、蔡志浩；权利人：梅州市志浩电子科技有限公司） |

**2022 年度广东省科学技术奖公示表**

**（自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、科技成果推广奖格式）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 高品质纤维复合基电子电路基板关键技术研发及产业化 |
| 主要完成单位 | 广东超华科技股份有限公司 |
| 华南理工大学 |
| 主要完成人 (职称、完成单 位、工作单位) | 刘德桃（副研究员、工作单位：华南理工大学；完成单位：华南理工大学；主要贡献：创新点1的主要完成人，是高频高速基板研发与应用的项目负责人之一，主要负责纤维复合基半固化片及高频高速基板关键技术研发及复合材料功能构筑方法与材料复合新技术；是专利1、专利2、专利3、专利4、专利6、专利9和专利10的发明人，是论文1、论文2、论文4的通讯作者） |
| 周佩君（高级工程师、工作单位：广东超华科技股份有限公司、完成单位：广东超华科技股份有限公司、主要贡献：创新点1、2的主要完成人，是高频高速基板研发与应用项目负责人之一，负责高品质纤维复合基电子电路基板产业化及新产品应用。是专利1、专利5、专利8的发明人） |
| 李志鸿（工程师、工作单位：广东超华科技股份有限公司、完成单位：广东超华科技股份有限公司、主要贡献：创新点1的主要完成人，负责高品质纤维复合基电子电路基板生产工艺研发与产品测试、可靠性分析及应用研究技术支持。是专利1的发明人） |
| 温带军（工程师、工作单位：广东超华科技股份有限公司、完成单位：广东超华科技股份有限公司、主要贡献：创新点1的主要完成人，负责高品质纤维复合基电子电路基板中试与生产关键技术研发。是专利1、专利5的发明人，是论文5的作者） |
| 梁宏(未取得、工作单位：广东超华科技股份有限公司、完成单位：广东超华科技股份有限公司、主要贡献：创新点1、2的主要完成人，负责高品质纤维复合基电子电路基板项目产业化生产线规划、实施及筹建工作。是专利1的发明人） |
| 王斌（副研究员、工作单位：华南理工大学、完成单位：华南理工大学、主要贡献：创新点1的主要完成人，主要负责纤维功能化改性及特种纤维复合材料研制与应用，是论文3的通讯作者） |
| 孟基中（助理工程师、工作单位：广东超华科技股份有限公司、完成单位：广东超华科技股份有限公司、主要贡献：创新点2的主要完成人，负责超薄、低轮廓电解铜箔关键技术研发与产业化应用，是专利8的发明人，是论文5的第一作者） |
| 林美燕（未取得、工作单位：华南理工大学、完成单位：华南理工大学、主要贡献：创新点1的主要完成人，负责高品质纤维复合基半固化片试验研究、材料制备与测试分析。是专利1、专利2、专利3、专利4、专利6、专利9和专利10的发明人，是论文2，论文4的第一作者，论文1的作者） |
| 刘斯丹（经济师、工作单位：广东超华科技股份有限公司、完成单位：广东超华科技股份有限公司、主要贡献：创新点1、2的主要完成人，负责高品质纤维复合基电子电路基板生产工艺研发、产品测试与产业化应用。是专利1的发明人） |
| 江瑞棠（未取得、工作单位：广东超华科技股份有限公司、完成单位：广东超华科技股份有限公司、主要贡献：创新点2的主要完成人，负责超薄、低轮廓电解铜箔工艺技术研发与产品测试、应用分析。是专利7的发明人） |
| 代表性论文 专著目录 | 论文1：Preparation of robust aramid composite papers exhibiting water resistance by partial dissolution/regeneration welding, 国际SCI期刊：Materials and Design，发表时间：2019年12月2日；2022年187卷，文献号：108404，论文作者：徐科，欧阳豪，李映辉，苏灵峰，林美燕，李杨，崔结东，刘德桃（第一作者：徐科, 通讯作者: 刘德桃） |
| 论文2：Thermally conductive nanostructured, aramid dielectric composite films with boron nitride nanosheets，国际SCI期刊：Composites Science and Technology，发表时间：2019年2月7日；2019年175卷，页码：85-91，论文作者：林美燕, 李映辉，徐科，欧阳豪，苏灵峰，冯晓，李军，祁海松，刘德桃 (第一作者：林美燕, 通讯作者：刘德桃) |
| 论文3：A water solvent-assisted condensation polymerization strategy of superhydrophobic lignocellulosic fibers for efficient oil/water separation，国际SCI期刊：Journal of Materials Chemistry A，发表时间：2019年7月21日；2019年7卷27期，页码:16447-16457，论文作者：康磊，李金鹏，曾劲松，高文花，徐俊，程峥，陈克复，王斌（第一作者：康磊，通讯作者 王斌，程峥） |
| 论文4：Highly mechanical nanostructured aramid-composites with gradient structures, 国际SCI期刊：Composites Part A，发表时间：2019年1月5日；2019年118期，页码:250-258，论文作者：欧阳豪，林美燕，苏灵峰，冯晓，王明，李军，刘德桃，祁海松 (第一作者：林美燕，通讯作者：刘德桃，祁海松) |
| 论文 5 ：高频高速电路用低轮廓电解铜箔的生产与技术研讨, 2020年中国电子铜箔行业年会暨梅州市铜箔产业大会：发表时间：2020年11月27日；页码：27-35；论文作者：孟中基，刘吉扬，陈亮 (第一作者：孟中基) |
| 知识产权名称 | 专利1：一种高频高速基板用半固化片的制造方法 ，国家发明专利，授权公告日：2020年10月02日；专利授权号：ZL201810212154.5; 发明人；周佩君、刘德桃、吴寿强、林美燕、梁宏、黄小芸、温带军、李志鸿、刘斯丹；专利权人：广东超华科技股份有限公司，华南理工大学，梅州超华电子绝缘材料有限公司) |
| 专利2：<一种高导热绝缘芳纶半固化片及其制造方法> ，国家发明专利，授权公告日：2019年11月15日；发明专利授权号：ZL201710680629.9;发明人；刘德桃、林美燕、路朋博、欧阳豪、苏灵峰；专利权人：华南理工大学) |
| 专利3：<一种低介电聚全氟乙丙烯覆铜板及其制备方法> ，国家发明专利，授权公告日：2020年08月18日；发明专利授权号：ZL201910430029.6;发明人；刘德桃、李映辉、徐科、林美燕、欧阳豪、苏灵峰；专利权人：华南理工大学) |
| 专利4：<一种高强度芳纶纸张及其溶解复压自增强的制备方法> ，国家发明专利，授权公告日：2018年06月22日；发明专利授权号：ZL201610405271.4;发明人；刘德桃、路朋博、程凡、林美燕、欧阳豪、陈克复；专利权人：华南理工大学) |
| 专利5：<防止覆铜板压制过程中流胶的方法及其专用装置> ，国家发明专利，授权公告日：2014年10月15日；发明专利授权号：ZL201210289538.X;发明人；周佩君、许明学、吴站营、温带军、钟伟平、王子进、杨忠岩、吴洪；专利权人：广东超华科技股份有限公司) |
| 专利6：<间位芳纶纤维/玻璃纤维纸基覆铜箔层压板及其制造方法> ，国家发明专利，授权公告日：2019年10月18日；发明专利授权号：ZL201710646079.9;发明人；刘德桃、林美燕、路朋博、欧阳豪、苏灵峰；专利权人：华南理工大学) |
| 专利7：<一种电解铜箔抗氧化用高分子溶液涂敷装置> ，实用新型专利，授权公告日：2022年07月26日；发明专利授权号：ZL202220290172.7;发明人；陈亮、林富城、江瑞棠、刘吉扬；专利权人：广东超华科技股份有限公司) |
| 专利8：<一种节能环保电解铜箔生液溶铜装置> ，实用新型专利，授权公告日：2014年06月04日；发明专利授权号：ZL201620856767.5;发明人；周佩君、杨忠岩、孟中基、黄林、刘吉扬、廖承坤、刘俊斌；专利权人：广东超华科技股份有限公司，广州三祥多层电路有限公司，惠州合正电子科技有限公司) |
| 专利9：<一种柔性透明导电纳米薄膜的制备方法> ，国家发明专利，授权公告日：2017年04月09日；发明专利授权号：ZL201710680393.9;发明人；刘德桃、路朋博、程凡、欧阳豪、林美燕、苏灵峰；专利权人：华南理工大学) |
| 专利10：<一种基于纳米纤维素的可控雾度纳米纸及其制备方法> ，国家发明专利，授权公告日：2020年12月22日；发明专利授权号：ZL201910822656.4;发明人；刘德桃、苏灵峰、李映辉、徐科、欧阳豪、林美燕；专利权人：华南理工大学) |
| 补充说明 | 论文5的国内论文发表无通讯作者标注 |

**2022年度广东省科学技术奖公示表**

**（科技成果推广奖）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 南药梅片树高效繁育及栽培技术示范推广 |
| 主要完成单位 | 1. 梅州市农林科学院林业研究所 |
| 2. 广东兴源农林有限公司 |
| 3. 大埔县定源绿化有限公司 |
| 4. 梅州市桂冠生物科技有限公司 |
| 5. 广东金田生物科技有限公司 |
| 6. 梅州市梅县区农业农村服务中心 |
| 7. 平远县林业科技推广站 |
| 主要完成人（职称、完成单位、工作单位） | 1. 谢金兰

职称：正高级工程师完成单位：梅州市农林科学院林业研究所工作单位：梅州市农林科学院林业研究所主要贡献：主持完成科技成果“梅片树高效繁育及栽培技术研究”的鉴定 ；主要负责开展了梅片树资源调查、选育研究和种质资源圃建设，指导应用扦插和高位换冠嫁接技术培育出优良无性系苗木，开展了高效栽培技术和加工应用研究，指导全市各林场营建了林下栽培试验示范基地，并主持开展了技术培训推广（对应主要科技创新中所列第1、2、3、4项创新点）。发表论文5 篇。 |
| 1. 范剑明

职称：高级工程师完成单位：梅州市农林科学院林业研究所工作单位：梅州市农林科学院林业研究所主要贡献：开展扦插试验及扦插繁育植株的调查工作；参与林下栽培梅片树研究和试验示范；参与调查、选育梅片树高产株系；主持开展了技术培训推广。对应主要科技创新中所列第1、2、3项创新点。 |
| 1. 温秀凤

职称：工程师完成单位：梅州市农林科学院林业研究所工作单位：梅州市农林科学院主要贡献：开展扦插试验及扦插繁育植株的调查工作；参与林下种植梅片树研究和试验示范；参与调查、选出梅片树高产株系；主持开展了技术培训推广。对应主要科技创新中所列第1、2、3项创新点。 |
| 1. 黄浩

职称：工程师完成单位：梅州市农林科学院林业研究所工作单位：梅州市农林科学院林业研究所主要贡献：开展扦插试验研究，参与制定《梅片树栽培技术规程》（企业标准）；开展精油提取实验，进行选育研究筛选出梅片高产株系；协助开展了技术培训推广。对应主要科技创新中所列第1、3项创新点。 |
| 1. 丁宝

职称：工程师完成单位：梅州市农林科学院林业研究所工作单位：梅州市农林科学院主要贡献：开展无性繁殖以及栽培技术试验示范，参与制定《梅片树栽培技术规程》（企业标准），主持开展了培训技术推广。对应主要科技创新中所列第2项创新点。 |
| 1. 肖腊兴

职称：高级工程师完成单位：梅州市农林科学院林业研究所工作单位：梅州市农林科学院林业研究所主要贡献：主要负责开展了梅片树资源调查、选育研究和种质资源圃建设，指导应用扦插和高位换冠嫁接技术培育出优良无性系苗木，开展了高效栽培技术和加工应用研究，指导全市各林场营建了林下栽培试验示范基地，并协助开展了技术培训推广（对应主要科技创新中所列第1、2、3、4项创新点）。 |
| 1. 陈新强

职称：工程师完成单位：梅州市农林科学院林业研究所工作单位：梅州市农林科学院林业研究所主要贡献：协助开展了梅片树资源调查、选育研究和种质资源圃建设，指导应用扦插和高位换冠嫁接技术培育出优良无性系苗木，开展了高效栽培技术和加工应用研究，指导全市各林场营建了林下栽培试验示范基地，协助开展了技术培训推广（对应主要科技创新中所列第1、2、3创新点）。发表论文2 篇。 |
| 1. 李志良

职称：正高级工程师完成单位：梅州市农林科学院林业研究所工作单位：梅州市农林科学院林业研究所主要贡献：主要负责开展了梅片树资源调查、选育研究和种质资源圃建设，指导应用扦插和高位换冠嫁接技术培育出优良无性系苗木，开展了高效栽培技术和加工应用研究，指导全市各林场营建了林下栽培试验示范基地，并主持开展了技术培训推广（对应主要科技创新中所列第1、2、3、4项创新点）。发表论文4篇。 |
| 1. 王德州

职称：工程师完成单位：广东兴源农林有限公司工作单位：广东兴源农林有限公司主要贡献：协助开展了梅片树资源调查、选育研究和种质资源圃建设，培育出优良无性系苗木，开展栽培技术试验示范，牵头制定《梅片树栽培技术规程》（企业标准），协助开展了技术培训推广（对应主要科技创新中所列第2项创新点）。 |
| 1. 魏锦秋

职称：高级工程师完成单位：梅州市农林科学院林业研究所工作单位：梅州市农林科学院林业研究所主要贡献：主要负责开展了梅片树资源调查、选育研究和种质资源圃建设，培育优良无性系苗木，开展了高效栽培技术和加工应用研究，指导全市各林场营建了林下栽培试验示范基地，并协助开展了技术培训推广（对应主要科技创新中所列第1、2、3、4项创新点）。发表论文2篇。 |
| 代表性论文专著目录 | 论文1：名称：药用植物梅片树扦插繁育技术研究；期刊：中南林业科技大学学报；年卷：2016年第 36卷；第一作者：李志良；通讯作者：李志良。 |
| 论文2： 基于正交试验的梅片树扦插育苗研究；期刊：林业与环境科学；年卷：2017年第 33卷；第一作者：谢金兰；通讯作者：谢金兰。 |
| 论文3：高右旋龙脑含量梅片树良种选育研究；期刊：林业科技通讯；年卷：2017年第 8期；第一作者：陈新强；通讯作者：陈新强。 |
| 论文4：不同条件下药用植物梅片树生长差异分析；期刊：现代农业科技；年卷：2017年第 11期；第一作者：陈桂琼；通讯作者：陈桂琼。 |
| 论文5： 梅片树药用价值与栽培技术探析；期刊：绿色科技；年卷：2017年第 3期；第一作者：曾丽芳；通讯作者：曾丽芳。 |
| 知识产权名称 | 专利1：名称：一种龙脑型阴香树的扦插繁育方法（专利授权号：ZL201510765630.2；发明人：李志良、张汉永、凌凤清、陈桂琼、肖腊兴、罗万业、陈聪、曾令海、苏健裕、林胜；权利人：梅州市农林科学院林业研究所、广东华清园生物科技有限公司） |

# **2022年度广东省科学技术奖公示表**

# **（自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、科技成果推广奖格式）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **锂离子电池用高性能电解铜箔生箔工艺及添加剂的研发与推广应用** |
| **拟提名奖项及等级** | **科技成果推广奖** |
| **主要完成单位** | **嘉应学院** |
| **主要完成人****（职称、完成单位、工作单位）** | 1.唐春保（教授、嘉应学院、嘉应学院、技术成果的发明人，统筹整个项目的成果转化） |
| 2.刘燕（讲师、嘉应学院、嘉应学院、对PVA轮离线研磨阴极辊技术的研发） |
| 3.何柏田（讲师、嘉应学院、嘉应学院、研发专用添加剂技术） |
| 4.陈桂庭（讲师、嘉应学院、嘉应学院、多级过滤电解液净化技术的研发） |
| 5.戴传波（讲师、嘉应学院、嘉应学院、研发铜箔生箔工艺的新型添加剂） |
| 6.王永森（助理工程师、嘉应学院表面技术研究所、嘉应学院表面技术研究所、研究铜箔结晶体细化均匀处理技术） |
| **代表性论文****专著目录** | 论文1：<电解铜箔生产中降低氯离子浓度的 4 种方法及效果、材料保护、2013年46卷、张丰如、唐春保> |
| 论文2：<杂质离子对电解铜箔生产质量的影响、电镀与精饰、2015年37卷、张丰如、唐春保> |
| 论文3：<碘量法测定电解液中锰酸钾和高锰酸钾、电 镀 与 精 饰、2017年39卷、张丰如、唐春保> |
| 论文4：<钡盐 -活性炭联合处理铜箔电解液中微量铅、材料保护、2017年50卷、赖俐超、唐春保> |
| 论文5：< Wide-bandgap donor polymers based on a dicyanodivinyl indacenodithiophene unit for nonfullerene polymer solar cell、RSC Adv、2021年11卷、何柏田、陈桂庭> |
| **知识产权名称** | 专利1：<用于钛在酸性介质中的绿色缓蚀剂>（ZL201110253267.8、张丰如 赖俐超 唐春保 何优选、嘉应学院） |
| 专利2：<一种离子膜电解制备高锰酸钾的办法>（ZL201510325557.7、唐春保，刘燕等、广东航鑫科技股份公司，嘉应学院） |
| 专利3：<一种锂离子电池用网状铜箔的制备方法>（ZL201810956473.7、唐春保；刘燕；杨木强；谢静静；王永森；刘龙方、嘉应学院；梅州市材保科技有限公司） |
| 专利4：<一种降低电解铜箔电解液中铁离子浓度的装置及方法>（ZL201910756538.8、唐春保；谢静静；王永森；谢山、广东超华科技有限公司；嘉应学院） |

#